



1. 除了NNS-701本身与搭配的天线之外，不需要添加其他任何元器件。
2. 天线不需要匹配电路，OWITEK提供NFC天线设计技术支持
3. 电路占用面积小，芯片尺寸 7mm x 7mm x 1mm
4. 我们提供现成的驱动，降低软件开发门槛
5. 搭配模块内建微系统，快速实现卡模拟，读写器，P2P等完整NFC功能

52RD: 贵司讲到安全元件的实现有三种方式：SWP方案、全终端方案、MicroSD方案，这些方案的差异是什么？NNS-701支持的是哪种？

高总: 我想先用最简单的方式来说明什么是安全元件，NFC手机的主要用途之一就是可以进行卡片模拟，也就是将一张张的卡片虚拟电子化存放在手机中，因此手机内部须有安全元件(SE, Secure element)用以存放相关的数据资料，以保护使用者账户资料和钱包余额，以及允许进行安全交易。

这三种模式的选用主要还是依据NFC服务提供商的偏好来决定。简单的说：

1. 全终端模式：在先前NFC应用尚未开始成为趋势，谷歌结合了三星、hTC等手机制造商，将安全元件芯片直接内建在手机中。但是目前各国的银行金融业与电信运营商逐步加入战局，这一模式的应用比率应该会逐步下降。

2. SWP SIM: 大多数电信运营商目前也极度看好NFC的相关应用，因此运用一种新的SWP SIM卡做为安全元件抢食NFC市场。如联通在2012年11月宣布联合招商银行合作推动SWP SIM卡做为安全元件的NFC服务，移动也随即在2012年12月做出同样的服务。

3. NFC MicroSD卡：一种特殊规格的MicroSD卡，内含一个安全元件模块可以做为安全元件使用。主要都是银行金融业偏好使用。

这几种安全元件都是属于标准规格，NNS-701全部都支持。我们会协助客户依据需求来完成设计。

52RD: 对于手机支付，这个应该需要政府，银行的支持。你怎么看这一块的国内市场？

高总: 目前国家已经在制定各项相关的标准，预计2013年初就会正式出台。在国家的政策支持下，银联，银行，运营商早已经私下部署准备抢食这块市场。NFC的应用是手机支付其中的一个比较有潜力的应用模式，但也是各种应用模式中，最具备长期发展潜力的一种。因此相关的硬件如手机，平板，读写设备等生产制造商，应该尽速加快终端产品的开发速度，以抢占市场先机。

52RD: 贵司NNS-701对软硬件平台有什么要求？

高总: NNS-701对于硬件平台没有太大的要求，基本上600MHz以上的CPU，安卓系统我们建议采用2.3.4以上即可。非安卓系统，我们也可以提供对应的技术支持服务。同时我们也即将针对Windows 8 Phone提供设计支持。

52RD: 之前传闻iphone5会带NFC，可惜最终还没有带NFC。在贵司看来，明年的Iphone5S是否有机会用NFC？

高总: 这个问题最能回答的应该是Apple本身，只有Apple才能确定是否会在下一代的iPhone中增添NFC功能。但是首先从商业角度来看，iOS6的Passbook功能非常完善，可以完整的管理各种票券、折价券等，界面也非常亲善，但是如果结合NFC功能，会让Passbook更为强大，操作更为简易。

从技术面来说，Apple在NFC相关的技术与应用面上也取得不少的专利，这增加了一定的可能性。另外虽然iPhone的背盖是铝合金，对NFC天线来说是一个极大的致命困扰，但是在铝合金背盖上设计NFC天线，也不是完全不可行，例如Sony LT22i，就是在铝合金背盖上放置NFC天线。

所以若是在2013年全球各地的NFC热潮如果能持续扩散，下一代iPhone是有较高的机率增加NFC功能。

(来源：我爱研发网 于晶晶\文)